

課題番号 : F-13-WS-0087
利用形態 : 技術相談
利用課題名 (日本語) : 銅版の酸化膜厚の測定
Program Title (English) : Thickness measurement of oxidized layer in copper plates
利用者名 (日本語) : 田嶋寛悦
Username (English) : H. Tajima
所属名 (日本語) : (株)UKCエレクトロニクス
Affiliation (English) : UKC electronics Co., Ltd.

1. 概要 (Summary)

製造メーカーの異なる銅版があり、それぞれについて、5条件の熱処理を実施した。熱処理条件により、銅版の表面に形成される酸化膜厚がどのように変化するか数値化したいという相談である。

これに関しては、GD-OESを用いた銅版の酸素状態の評価、並びに Ar ガススパッタリングによる銅版のエッチングレートを触針式段差計による評価で行うことが適当であることを説明し、今後、この方法で評価することとした。

2. 実験 (Experimental)

なし。

3. 結果と考察 (Results and Discussion)

なし。

4. その他・特記事項 (Others)

なし。

5. 論文・学会発表 (Publication/Presentation)

なし。

6. 関連特許 (Patent)

なし。